



セキュアな  
コネクテッド  
システムオンモジュール

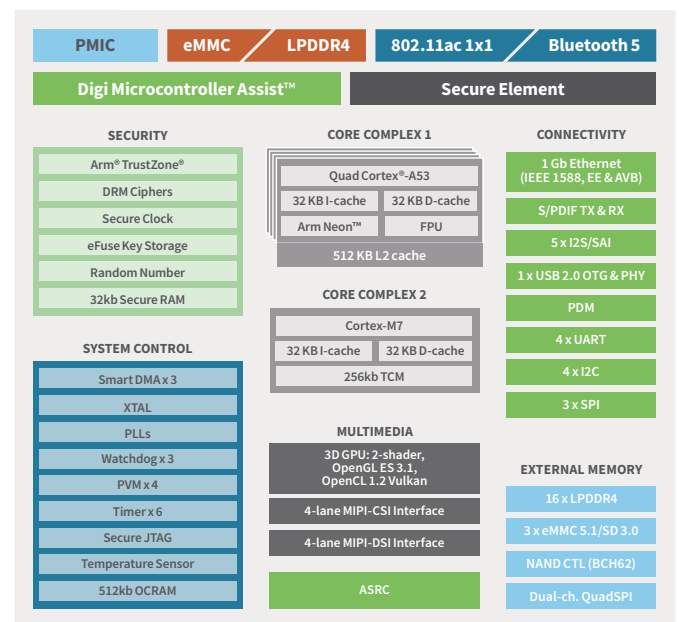


# DIGI CONNECTCORE 8M NANO

インダストリアル向けIoTアプリケーションの長寿命とスケーラビリティを実現するために設計された NXP i.MX 8M Nano プロセッサベースの組込みシステムオンモジュールです。

NXP® i.MX 8M Nano アプリケーションプロセッサをベースにした Digi ConnectCore® 8M Nano は、統合されたシステムオンモジュール (SOM) プラットフォームです。Nano は、モノのインターネット (IoT)、ヒューマンマシンインタフェース (HMI)、機器監視、音声、エッジコンピューティング、機械学習 (異常検出など) といった工業、医療、農業、輸送の幅広いアプリケーション向けに設計されています。

Digi ConnectCore 8M Nano は、最大4つの電力効率に優れた Arm® Cortex®-A53 コアと1つの Cortex-M7 コアを備えており、高水準のパフォーマンスを維持しながら電力消費を最小限に抑えることが可能です。この SOM は、インダストリアル向けの信頼性と組込みデバイスの10年以上の製品ライフサイクルを実現するように設計されています。OEM は、認証取得済み(申請中)のワイヤレスコネクティビティ、リモートマネジメント、クラウドインタグレーション、Yocto Project® ベースのすべて揃った Linux® ソフトウェアプラットフォームを活用することにより、R&D や開発のコストと TCO の削減に寄与します。さらに、ビルトインの Digi TrustFence® により、OEM 開発者はクリティカルなセキュリティとデータプライバシー機能を製品にインテグレートできます。



## 特長

- インダストリアル i.MX 8M Nano シングル/クアドコアシステムオンモジュール
- 究極の信頼性とデザインの自由度を実現する Digi SMTplus® フォームファクタ (40 mm × 45 mm)
- 低電力設計のためのハードウェアおよびソフトウェア双方をサポートするパワーマネジメント
- ハードウェアアクセラレーションを備えたディスプレイおよびカメラ機能
- 認証取得済み(申請中)のデュアルバンド 802.11a/b/g/n/ac 1x1 および Bluetooth® 5 コネクティビティ
- セルラーモデムと Digi XBee® のシームレスな統合
- クラウドとエッジコンピューティングサービスの統合
- Digi TrustFence® を備えたビルトインのデバイスセキュリティ、ID、プライバシー
- Digi Remote Manager® によるリモート監視・管理
- Yocto Project® Linux® 対応

## 関連製品



ConnectCore  
8M Nano Dev Kit



ConnectCore  
8X



ConnectCore  
6UL



Digi XBee®  
Modules



ConnectCore  
8X SBC Pro Dev Kit

SPECIFICATIONS	Digi ConnectCore® 8M Nano
アプリケーションプロセッサ	NXP i.MX8 Nano <ul style="list-style-type: none"> <li>最大4のCortex-A53コア@ 1.4 GHz</li> <li>Cortex-M7コア@ 750 MHz (リアルタイムプロセッシング)×1</li> </ul>
メモリ	最大8 GB eMMC, 最大1GB LPDDR4 (16ビット)
PMIC	Rohm BD71850MWV
グラフィックス	グラフィックプロセッシングユニット: <ul style="list-style-type: none"> <li>GC7000UL (OpenCLおよびVulkan対応)</li> <li>shader×2</li> <li>12,300万 triangles / 秒</li> <li>0.8 ギガpixel / 秒</li> <li>12.8 GFLOPs 32ビット / 12.8 GFLOPs 16ビット</li> <li>OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0, OpenCL 対応</li> <li>shaderクロック周波数: 500 MHz</li> </ul> LCDIF ディスプレイコントローラ(最大1080p 60fps ディスプレイ : MIPI DSI経由) 4-lane MIPI DSI インタフェース
セキュリティ	Digi TrustFence®, TRNG, TrustZone, Secure RTC, Secure JTAG, Secure Element
ペリフェラル/インタフェース	USB 2.0 OTG コントローラ (PHYインタフェース付属)×1 Ultra Secure Digital Host コントローラ (uSDHC) インタフェース×3 Gigabit Ethernet コントローラ×1 Universal Asynchronous Receiver / Transmitter (UART) モジュール×4 I2Cモジュール×4 SPIモジュール×3
イーサネット	10/100/1000M Ethernet + AVB
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/acデュアルバンドワイヤレス×1
Bluetooth	Bluetooth® 5
オンモジュールマイクロコントローラ アシスト	Digi Microcontroller Assist™ <ul style="list-style-type: none"> <li>独立したCortex-M0+ マイクロコントローラサブシステム</li> <li>超低電力モード @ &lt;3 μA</li> </ul>
動作温度	工業用: -40℃～85℃ (使用条件や筐体/システムの設計により異なります)
保管温度	-50℃～125℃
相対湿度	5%～90% (結露なきこと)
電波法認証	米国、カナダ、EU、日本(申請中)、オーストラリア/ニュージーランド
EMI/電磁波耐性/安全	FCC Part 15 Class B, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES- 003 Class B, VCCI Class II, AS 3548, FCC Part 15 Subpart C Section 15.247, IC (Industry Canada), RSS-210 Issue 5 Section 6.2.2(o), EN 300 328, EN 301 489-17, EN 55024, EN 301 489-3
設計検証	温度: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78 振動/衝撃: IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-27, HALT
機構的特徴	118 castellated vias, LGA-474, 1.27 mmピッチ, フルシールド; 電波放射および温度管理(熱拡散) 40 mm×45 mm×3.5 mm
製品保証	3年

PART NUMBERS	DESCRIPTION
<b>DIGI CONNECTCORE® 8M NANO DEVELOPMENT KITS</b>	
CC-WNX8MN-KIT	Digi ConnectCore 8M Nano development kit with development board, Quad Core, 8 GB eMMC, 1 GB LPDDR4 Wireless
<b>DIGI CONNECTCORE 8M NANO SOMS</b>	
CC-WMX-FS7D-NN	Digi ConnectCore 8M Nano, Quad Core, 8 GB eMMC, 1 GB LPDDR4 Wireless
CC-WMX-FR6D-NN	Digi ConnectCore 8M Nano, SoloLite Core, 8 GB eMMC, 512 MB LPDDR4 Wireless
CC-MX-FS7D-ZN	Digi ConnectCore 8M Nano, Quad Core, 8 GB eMMC, 1 GB LPDDR4 Ethernet
CC-MX-FR6D-ZN	Digi ConnectCore 8M Nano, SoloLite Core, 8 GB eMMC, 512 MB LPDDR4 Ethernet

ACCESSORIES	DESCRIPTION
CC-ACC-LCDW-10	LCD application kit, including 10 in WXGA (1280x800) LCD panel with PCAP touch



## ディジ インターナショナル株式会社

〒150-0031

東京都渋谷区桜丘町22-14 NESビルS棟8F

TEL:03-5428-0261 mail@dig-intl.co.jp

[www.digi-intl.co.jp](http://www.digi-intl.co.jp)

© 1996-2021 Digi International Inc.

●記載した仕様は予告なく変更する場合があります。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。



2021/02 (A7/121)